

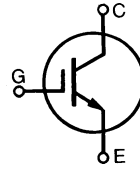
IGBT

IXGA/IXGP12N100

IXGA/IXGP12N100A

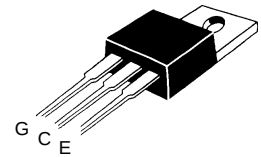
V_{CES}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
1000 V	24 A	3.5 V
1000 V	24 A	4.0 V

Preliminary Data Sheet

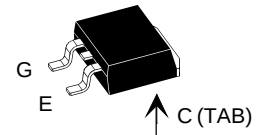


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	1000	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GE} = 1\text{ M}\Omega$	1000	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	24	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	12	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, 1 ms	48	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15\text{ V}$, $T_{VJ} = 125^\circ\text{C}$, $R_G = 150\ \Omega$ Clamped inductive load, $L = 300\ \mu\text{H}$	$I_{CM} = 24$ @ 0.8 V_{CES}	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	100	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque with screw M3 Mounting torque with screw M3.5	0.45/4 0.55/5	Nm/lb.in.
Weight		4	g
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$

TO-220AB (IXGP)



TO-263 (IXGA)



Features

- International standard packages JEDEC TO-220AB and TO-263AA
- Second generation HDMOS™ process
- Low $V_{CE(sat)}$
 - for minimum on-state conduction losses
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

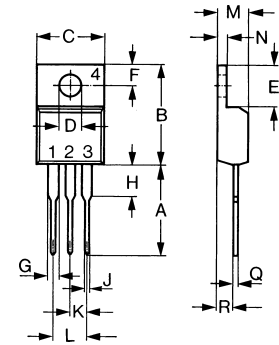
Advantages

- Easy to mount with one screw
- Reduces assembly time and cost
- High power density

Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{CES}	$I_C = 3\text{ mA}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	1000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\ \mu\text{A}$, $V_{GE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
I_{CES}	$V_{CE} = 0.8$, V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C}$		250 μA
	$V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_J = 125^\circ\text{C}$		1 mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 20\text{ V}$			$\pm 100\text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{CE90}$, $V_{GE} = 15$	12N100 12N100A		3.5 V 4.0 V

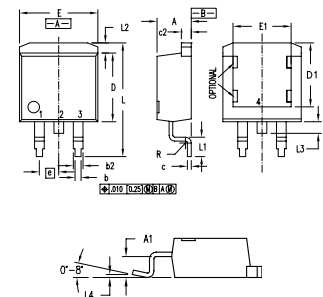
Symbol	Test Conditions ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Pulse test, $t \leq 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	6	10	S
Q_g	$I_C = I_{C90}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5\text{ V}_{CES}$	65	90	nC
Q_{ge}		8	20	nC
Q_{gc}		24	45	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $L = 300\text{ }\mu\text{H}$ $V_{CE} = 800\text{ V}$, $R_G = R_{off} = 120\text{ }\Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8\text{ V}_{CES}$, higher T_J or increased R_G	100		ns
t_{ri}		200		ns
$t_{d(off)}$		850	1000	ns
t_{fi}		500	700	ns
E_{off}		12N100A	800	1000 ns
		12N100A	2.5	4 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $L = 300\text{ }\mu\text{H}$ $V_{CE} = 800\text{ V}$, $R_G = R_{off} = 120\text{ }\Omega$ Remarks: Switching times may increase for $V_{CE}(\text{Clamp}) > 0.8\text{ V}_{CES}$, higher T_J or increased R_G	100		ns
t_{ri}		200		ns
E_{on}		1.1		mJ
$t_{d(off)}$		900		ns
t_{fi}		12N100A	950	ns
		12N100	1250	ns
E_{off}		12N100A	4	mJ
		12N100	6	mJ
R_{thJC}				1.25 K/W
R_{thCK}			0.25	K/W

TO-220 AB (IXGP) Outline



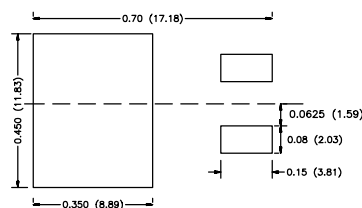
Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	12.70	13.97	0.500	0.550
B	14.73	16.00	0.580	0.630
C	9.91	10.66	0.390	0.420
D	3.54	4.08	0.139	0.161
E	5.85	6.85	0.230	0.270
F	2.54	3.18	0.100	0.125
G	1.15	1.65	0.045	0.065
H	2.79	5.84	0.110	0.230
J	0.64	1.01	0.025	0.040
K	2.54	BSC	0.100	BSC
M	4.32	4.82	0.170	0.190
N	1.14	1.39	0.045	0.055
Q	0.35	0.56	0.014	0.022
R	2.29	2.79	0.090	0.110

TO-263 AA (IXGA) Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.06	4.83	.160	.190
A1	2.03	2.79	.080	.110
b	0.51	0.99	.020	.039
b2	1.14	1.40	.045	.055
c	0.46	0.74	.018	.029
c2	1.14	1.40	.045	.055
D	8.64	9.65	.340	.380
D1	7.11	8.13	.280	.320
E	9.65	10.29	.380	.405
E1	6.86	8.13	.270	.320
e	2.54	BSC	.100	BSC
L	14.61	15.88	.575	.625
L1	2.29	2.79	.090	.110
L2	1.02	1.40	.040	.055
L3	1.27	1.78	.050	.070
L4	0	0.38	0	.015
R	0.46	0.74	.018	.029

Min. Recommended Footprint



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9